



### RE901

- Platine à adaptateur multiple doté de six éléments semi-conducteurs micro-miniature
- Fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm
- Simple face 35 µm Cu
- Surface avec Ni/Au chimique et un laque d'arrêt de soudure
- Impression d'insertion
- Le placement de 20 différents types de semi-conducteurs énoncés dans le tableau est possible sur la platine
- Baguette à 8 broches pas 2,54 mm
- Perforation 1,00 mm Ø
- Point destiné à la rupture de séparation des modules
- Les données Data Gerber d'apprêt pour l'établissement de l'application de pâte à braser seront mis à la disposition gratuitement
- Dimensions 22,86 mm x 46,72 mm

Layout	Pad (mm)	Pitch	Taille	Configuration	Occupation
TO252	*	*	*	*	TO252
SOT223	*	*	*	*	SOT223
SOT89	*	*	*	*	SOT89A
SOT23	0,710 x 1,000	0,950 mm	2,400 mm	2 Reihen x 3	SC59, SC74, SC74A, SMT3, SMT5, SMT6, SOT23, SOT23-5, SOT23-6
SOT23-8	0,460 x 1,100	0,650 mm	2,400 mm	2 Reihen x 4	SC70, SC88A, SOT23-8, UMT3, UMT5, UMT6
SC75	*	*	*	*	EMT3, SC75